

中科寒武纪科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“寒武纪”）编制了截至2025年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2020〕1214号同意注册文件，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,010万股，发行价为每股人民币64.39元，共计募集资金258,203.90万元，坐扣承销和保荐费用4,888.00万元（其中，不含税承销及保荐费为人民币4,611.32万元，该部分属于发行费用；税款为人民币276.68万元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为253,315.90万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,825.29万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为249,767.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕261号）。

2、2022年度向特定对象发行情况

经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕424号），公司2022年度向特定对象发行A股股票13,806,042股，每股发行价格为人民币121.10元，募集资金总额为人民币1,671,911,686.20元，扣除各项发行费用（不含税）人民币22,621,676.59元后，实际募集资金净额为人民币1,649,290,009.61元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、首次公开发行情况

截至2025年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额/单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2025年3月31日余额	备注
招商银行北京分行大运村支行	9551018300000088	69,973.07	已注销	募集资金专户
招商银行北京分行大运村支行	9551068600000088	60,016.97	已注销	募集资金专户
招商银行北京分行大运村支行	9551088500000088	60,072.47	已注销	募集资金专户
中信银行北京广安门支行	8110701012366688256	63,253.39	已注销	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004851		已注销	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004850		已注销	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600004852		已注销	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100002996		已注销	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100002997		已注销	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100002998		已注销	募集资金专户
合计	/	253,315.90	/	

[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在3,548.61万元的差异，原因系：(1)初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3,825.29万元；(2)坐扣承销和保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款276.68万元。

2、2022年度向特定对象发行情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额/单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2025 年 3 月 31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000801		8,024.81	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000802		4,114.14	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000803		5,122.73	募集资金专户
招商银行股份有限公司北京大运村支行	110929757910606	165,071.17	0.00	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006799		273.59	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006800		444.21	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600007624		952.08	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100004581		55.57	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行	44250100004100004582		50.30	募集资金专户
合计	/	165,071.17	19,037.43	

[注]初始存放金额合计数与募集资金净额存在 142.17 万元的差异，原因系：(1)初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 282.17 万元；(2)坐扣承销及保荐费用时扣除了不属于发行费用的税款 118.8 万元；(3)坐扣了不属于发行费用的持续督导费 21.2 万元。

3、首次公开发行节余募集资金用于特定项目

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额/单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025 年 3 月 31 日余额	备注
中国建设银行股份有限公司北京中南路支行	11050163870009000805[注]	30,308.84	0.00	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司上海张江分行	31050161393600006935[注]	1,239.94	0.00	募集资金专户
合计	/	31,548.78	0.00	

[注]公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项后节余募集资金用于公司 2022 年向特定对象发行股票募投

项目“稳定工艺平台芯片项目”，11050163870009000805、31050161393600006935 账户系公司、上海寒武纪作为“稳定工艺平台芯片项目”实施主体对应开立的募集资金专户。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票”、“附件 3：前次募集资金使用情况对照表——2022 年度向特定对象发行股票”和“附件 5：前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行节余募集资金用于特定项目”。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2024 年 9 月 30 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》；2024 年 11 月 1 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由 69,973.68 万元调整到 44,973.68 万元，将调减的 25,000 万元永久补充公司流动资金，调减部分占 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额的比例为 15.16%；将 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78 万元全额调整为永久补充公司流动资金。本次募投项目变更事项，公司独立董事已召开专门会议审议通过，保荐机构无异议。上述具体情况可见公司于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明

截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告“附件 1：前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票”、“附件 3：前次募集资金使用情况对照表——2022 年度向特定对象发行股票”和“附件 5：前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行节余募集资金用于特定项目”。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票”、“附件 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022 年度向特定对象发行股票”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、首次公开发行情况

（1）公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺。

（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。

2、2022 年度向特定对象发行情况

公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

（1）公司向特定对象发行股票募投项目“先进工艺平台芯片项目”项目内容包括基于先进工艺平台研发高能效的智能芯片，并研发相应配套的基础系统软件；“稳定工艺平台芯片项目”内容包括建设稳定集成电路工艺制程下的芯片设计平台，开展不同算力档位的高集成度智能 SoC 芯片研发，并研发配套的基础系统软件；“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”内容包括研发面向新兴场景的智能指令集、处理器微体系结构、处理器功能和性能模拟器、软件工具链等。以上三个项目均为研发性质，旨在加强公司研发投入，持续迭代核心技术，加速推动智能芯片升级，提高芯片能效，进一步增强公司技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，无法单独核算效益。

（2）补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

公司于 2020 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在 2020 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 16 日之间可以滚动使用。

公司于 2021 年 8 月 11 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 19 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在 2021 年 8 月 17 日至 2022 年 8 月 16 日之间可以滚动使用。

公司于 2022 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在 2022 年 8 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日之间可以滚动使用。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日之间可以滚动使用。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理。上述额度在 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日之间可以滚动使用。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理的余额为 35,000.00 万元，具体情况如下：

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益率	备注
中国建设银行北京中关村分行	结构性存款	保本浮动收益型	35,000.00	2025/2/28	2025/4/25	0.8%-2.4%	未到期

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、首次公开发行情况

2023年7月18日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“新一代云端训练芯片及系统项目”“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项，并将“新一代云端训练芯片及系统项目”结项后节余募集资金504.20万元，用于永久补充流动资金；将“新一代云端推理芯片及系统项目”结项后节余募集资金12,645.56万元、“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项后节余募集资金18,852.28万元，合计节余资金共计31,497.84万元用于公司2022年向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”（实际金额均以资金转出当日结项募投项目专户的剩余金额为准），详见公司于2023年7月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

2、2022年度向特定对象发行情况

截至2025年3月31日，公司已累计使用募集资金总额为116,831.71万元，占前次募集资金净额的比例为70.84%；募集资金净额结余金额为54,037.44万元（包括累计收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额5,940.15万元，及未到期的结构性存款35,000.00万元），将继续用于募集资金投资项目。

3、首次公开发行节余募集资金用于特定项目

2024年11月1日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，将IPO节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的31,548.78万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。详见公司分别于2024年10月1日、2024年11月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施

地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

九、前次募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

2、2022 年度向特定对象发行情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

3、首次公开发行节余募集资金用于特定项目

截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

附件：

- 1.前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票
- 2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票
- 3.前次募集资金使用情况对照表——2022 年度向特定对象发行股票
- 4.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022 年度向特定对象发行股票
- 5.前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行节余募集资金用于特定项目

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额[注 1]：2,497,672,916.19						已累计使用募集资金总额：2,269,748,436.67				
变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00%						各年度使用募集资金总额： 2020 年：240,799,541.80 2021 年：803,825,360.65 2022 年：874,895,538.22 2023 年：350,227,996.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新一代云端训练芯片及系统项目	新一代云端训练芯片及系统项目	699,730,700.00	699,730,700.00	728,522,742.49	699,730,700.00	699,730,700.00	728,522,742.49	28,792,042.49[注 2]	2023 年 7 月
2	新一代云端推理芯片及系统项目	新一代云端推理芯片及系统项目	600,169,700.00	600,169,700.00	498,970,321.94	600,169,700.00	600,169,700.00	498,970,321.94	-101,199,378.06[注 3]	2023 年 7 月
3	新一代边缘端人工智能芯片及系统项目	新一代边缘端人工智能芯片及系统项目	600,724,700.00	600,724,700.00	445,207,556.05	600,724,700.00	600,724,700.00	445,207,556.05	-155,517,143.95[注 3]	2023 年 7 月
4	补充流动资金	补充流动资金	900,000,000.00	597,047,816.19	597,047,816.19	900,000,000.00	597,047,816.19	597,047,816.19	0.00	不适用
	合计	—	2,800,625,100.00	2,497,672,916.19	2,269,748,436.67	2,800,625,100.00	2,497,672,916.19	2,269,748,436.67	-227,924,479.52	

[注 1]：该金额为扣除发行费用后募集资金净额。

[注 2]：实际投入募集资金总额与承诺投资总额的差额系存放在新一代云端训练芯片及系统项目专项账户产生的存款利息一并投入使用所致。

[注 3]：实际投入募集资金总额与承诺投资总额的差额系部分设备、软件及 IP、材料存在复用情况节省相应支出且公司在项目建设期间对闲置募集资金进行现金管理产生收益所致。详见公司于 2023 年 7 月

19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——首次公开发行股票

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-3 月		
1	新一代云端训练芯片及系统项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新一代云端推理芯片及系统项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新一代边缘端人工智能芯片及系统项目	不适用	未做承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

前次募集资金使用情况对照表——2022 年度向特定对象发行股票

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额[注 1]： 1,649,290,009.61						已累计使用募集资金总额： 1,168,317,110.16				
变更用途的募集资金总额： 250,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例： 15.16 %						各年度使用募集资金总额： 2023 年： 88,278,209.38 2024 年： 648,229,518.54 2025 年 1-3 月： 431,809,382.24				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 止日项目 完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额[注 2]	实际投资金额	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额[注 2]	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资金额 的差额	
1	先进工艺平台芯片项目	先进工艺平台芯片项目	717,652,200.00	717,652,200.00	579,145,213.43	717,652,200.00	717,652,200.00	579,145,213.43	-138,506,986.57[注 3]	2026 年 5 月
2	稳定工艺平台芯片项目	稳定工艺平台芯片项目	699,736,800.00	449,736,800.00[注 5]	250,177,422.64	699,736,800.00	449,736,800.00[注 5]	250,177,422.64	-199,559,377.36[注 3]	2026 年 5 月
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	218,991,600.00	218,991,600.00	75,967,942.09	218,991,600.00	218,991,600.00	75,967,942.09	-143,023,657.91[注 3]	2026 年 5 月
4	补充流动资金	补充流动资金	35,531,200.00	12,909,409.61	13,026,532.00	35,531,200.00	12,909,409.61	13,026,532.00	117,122.39[注 4]	不适用
5	永久补充流动资金	永久补充流动资金	不适用	250,000,000.00	250,000,000.00	不适用	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	不适用
	合计	—	1,671,911,800.00	1,649,290,009.61	1,168,317,110.16	1,671,911,800.00	1,649,290,009.61	1,168,317,110.16	-480,972,899.45	—

[注 1]：该金额为扣除发行费用后募集资金净额。

[注 2]：“截止日募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

[注 3]:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异主要为截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金项目尚未结项。

[注 4]:实际投入募集资金总额与承诺投资总额的差额系存放在补充流动资金账户产生的存款利息一并投入使用所致。

[注 5]: 2024 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由 69,973.68 万元调整到 44,973.68 万元，调减的 25,000 万元将永久补充公司流动资金。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022 年度向特定对象发行股票

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-3 月		
1	先进工艺平台芯片项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	稳定工艺平台芯片项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

前次募集资金使用情况对照表——首次公开发行节余募集资金用于特定项目

截至 2025 年 3 月 31 日

编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司

金额单位：人民币元

首次公开发行节余募集资金用于特定项目总额[注 1]：315,487,797.04						已累计使用募集资金总额：323,833,231.04				
变更用途的募集资金总额[注 2]：323,833,231.04						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：102.65%						2024 年：323,833,226.43				
						2025 年 1-3 月：4.61				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	稳定工艺平台芯片项目	稳定工艺平台芯片项目	不适用	315,487,797.04	0.00	不适用	0.00[注 3]	0.00	0.00	2026 年 5 月
2	永久补充流动资金	永久补充流动资金	不适用	不适用	323,833,231.04	不适用	315,487,797.04	323,833,231.04	8,345,434.00	不适用
	合计	—	不适用	315,487,797.04	323,833,231.04	不适用	315,487,797.04	323,833,231.04	8,345,434.00	-

[注 1]：该金额为公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的节余募集资金实际转出金额，较 2023 年 7 月 19 日发布的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-049）披露的节余金额相比，增加的 50.94 万元为银行利息等收益。

[注 2]：该金额较首次公开发行节余募集资金用于特定项目总额增加 834.54 万元，为银行利息等收益。

[注 3]：2024 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78 万元将永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金额为准）。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）。